

# 外形図 Outline Drawing

RDK-G-000336

1/1

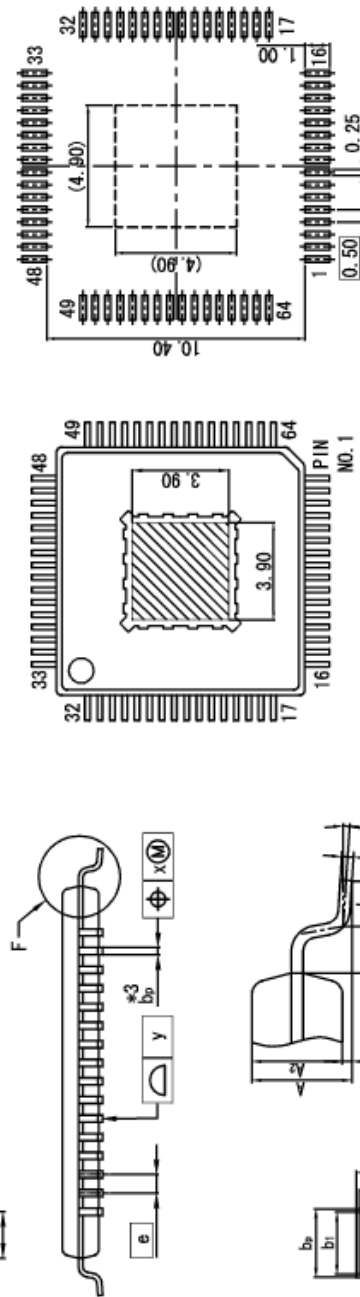
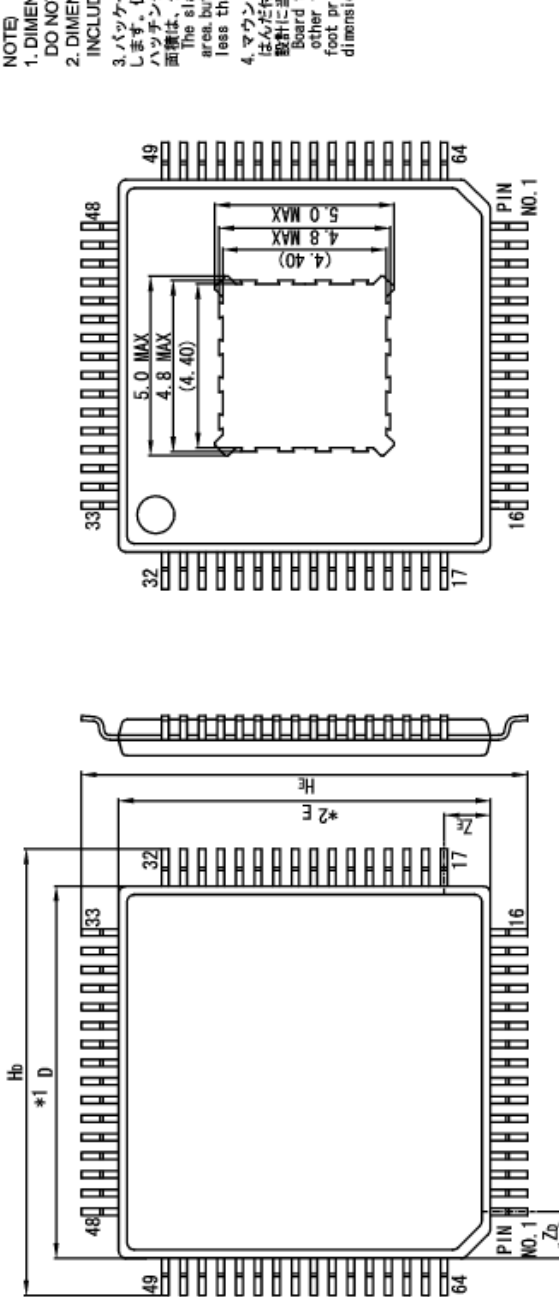
Renesas Electronics Corporation

- NOTE)
1. DIMENSIONS "1" AND "2" DO NOT INCLUDE MOLD FLASH.
  2. DIMENSION "3" DOES NOT INCLUDE TRIM OFFSET.

3. パッケージ裏面ソルダビリティ範囲は、ハッチング部とします。但し、部分的にレジン流出/フラッシュがハッチング部を超過した場合は、レジン流出/フラッシュ面積は、ダイパッド露出面積の20%以内とする。  
The slant line part is the solderability assurance area, but if in resin bleed/flash intrusion area is less than 20% of exposed die pad area.

4. マウントパッド露出量は、基板材料、はんだペースト材料、はんだ付け方法、装置精度によって変わります。実際の設計に当たっては状況にあわせて最適化を図ってください。  
Board type, solder material, mounting methods and other factors must all be considered in determining foot print dimensions. I practical design work dimension should be optimized to meet actual condition.

Reference Symbol	Dimension in Millimeters		
	Min	Nom	Max
D	-	10	-
E	-	10	-
A2	-	0.98	-
HD	11.8	12.0	12.2
HE	11.8	12.0	12.2
A	-	-	1.20
A1	0.05	0.10	0.15
bp	0.16	0.21	0.26
b1	-	0.19	-
c	0.095	0.145	0.195
c1	-	0.125	-
$\theta$	0°	-	8°
e	-	0.5	-
x	-	-	0.08
y	-	-	0.08
ZD	-	1.25	-
ZE	-	1.25	-
L	0.4	0.5	0.6
L1	-	1.0	-



ソルダビリティ保証範囲 [NTS]  
Solderability assurance range

フットプリント図 [NTS]  
Fig. Foot print

Terminal cross section  
Detail of F

JEITA Package Code	RENESAS Code	Previous Code	MASS [Typ.]
P-HTQFP64-10x10-0.50	PTQP0064KD-B	---	0.25g